

2.5V 到 5.5V、12/14/16Bit、内置基准、八通道数模转换器

产品简述

MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC，内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式，最高工作频率可以到 40MHz，可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5228/5248/5268 具有掉电模式，可以优化工作时的功耗。

MS5228 有 TSSOP14、TSSOP16、QFN16、CSP16 封装，MS5248 有 TSSOP14、TSSOP16 封装，MS5268 有 TSSOP16、QFN16、CSP16 封装。

主要特点

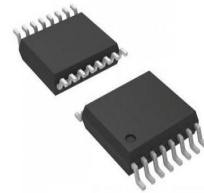
- MS5268: 16bits
- MS5248: 14bits
- MS5228: 12bits
- 内部基准电压温漂: 10ppm/°C (典型值)
- 集成内部可选 1.25V, 2.5V 基准
- 兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口
- 内部上电复位
- 集成 REF 缓冲器
- 输出范围是 2 倍的基准电压 (内置基准)
- 输出范围是 1 倍的基准电压 (外置基准)
- 软件、硬件 $\overline{\text{LDAC}}$ 功能
- 硬件 $\overline{\text{CLR}}$ 功能
- 软件 Power down
- 电源电压: 2.7V~5.5V

应用

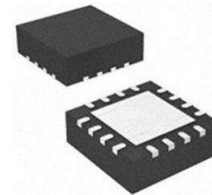
- 便携式仪器仪表
- 工业过程控制
- 机械和移动控制设备
- 可编程电压源和电流源



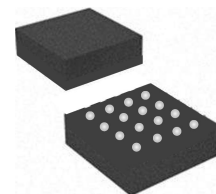
TSSOP14



TSSOP16



QFN16



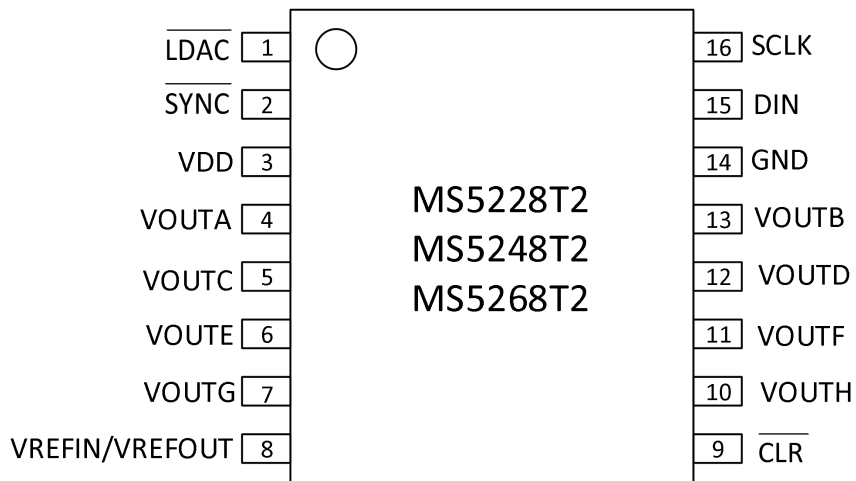
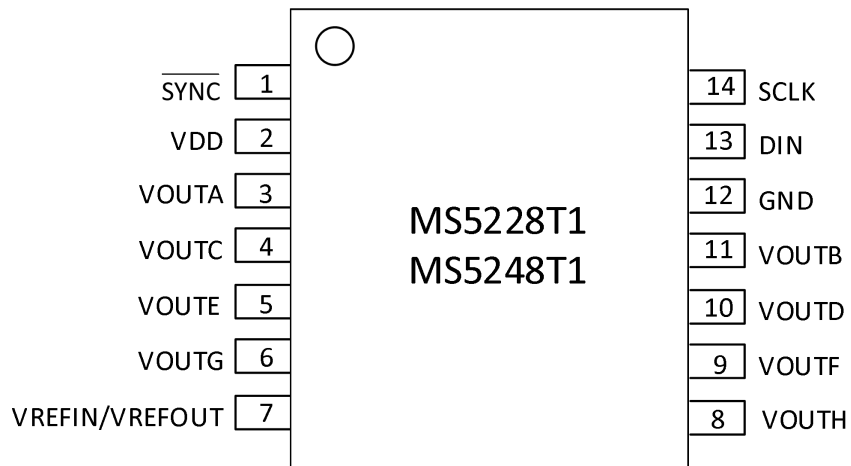
CSP16

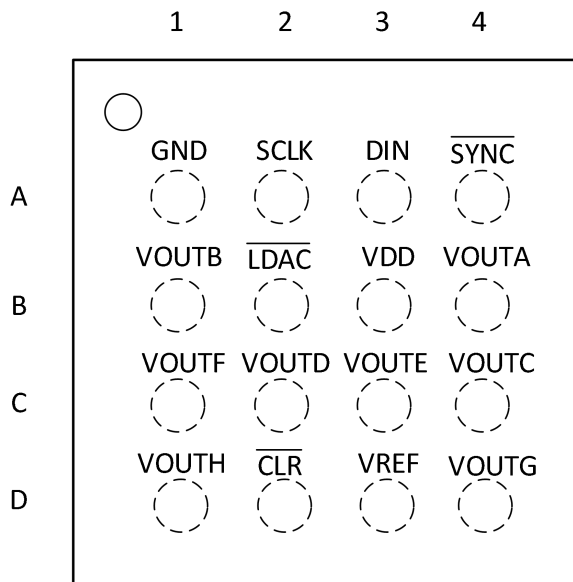
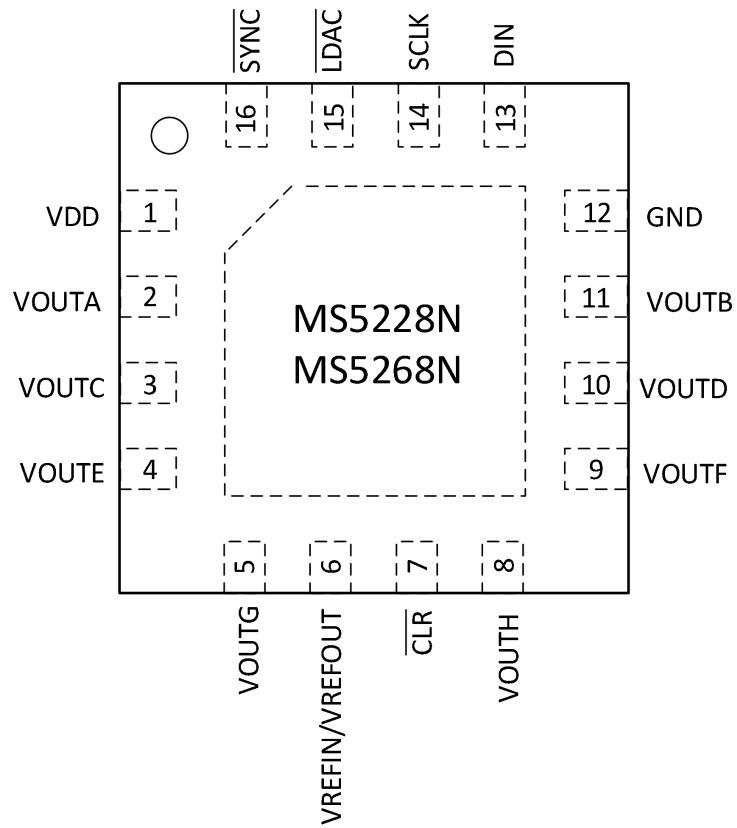
产品规格分类

产品名称	RANGE	封装形式	内置基准电压	默认上电输出电压	丝印名称
*MS5228T1	1	TSSOP14	1.25V	0V	MS5228T1
*MS5228T1	2	TSSOP14	2.5V	0V	MS5228T1
*MS5228T2	1	TSSOP16	1.25V	0V	MS5228T2
*MS5228T2	2	TSSOP16	2.5V	0V	MS5228T2
*MS5228N	1	QFN16	1.25V	0V	MS5228N
*MS5228N	2	QFN16	2.5V	0V	MS5228N
*MS5228C	1	CSP16	1.25V	0V	MS5228C
*MS5228C	2	CSP16	2.5V	0V	MS5228C
*MS5248T1	1	TSSOP14	1.25V	0V	MS5248T1
*MS5248T1	2	TSSOP14	2.5V	0V	MS5248T1
*MS5248T2	1	TSSOP16	1.25V	0V	MS5248T2
*MS5248T2	2	TSSOP16	2.5V	0V	MS5248T2
MS5268T2	1	TSSOP16	1.25V	0V	MS5268T2
MS5268T2	2	TSSOP16	2.5V	0V	MS5268T2
MS5268T2	3	TSSOP16	2.5V	0.5×FSR	MS5268T2
*MS5268N	1	QFN16	1.25V	0V	MS5268N
*MS5268N	2	QFN16	2.5V	0V	MS5268N
*MS5268N	3	QFN16	2.5V	0.5×FSR	MS5268N
*MS5268C	1	CSP16	1.25V	0V	MS5268C
*MS5268C	2	CSP16	2.5V	0V	MS5268C
*MS5268C	3	CSP16	2.5V	0.5×FSR	MS5268C

*暂未提供此封装。若有需要，请联系杭州瑞盟销售部

管脚图





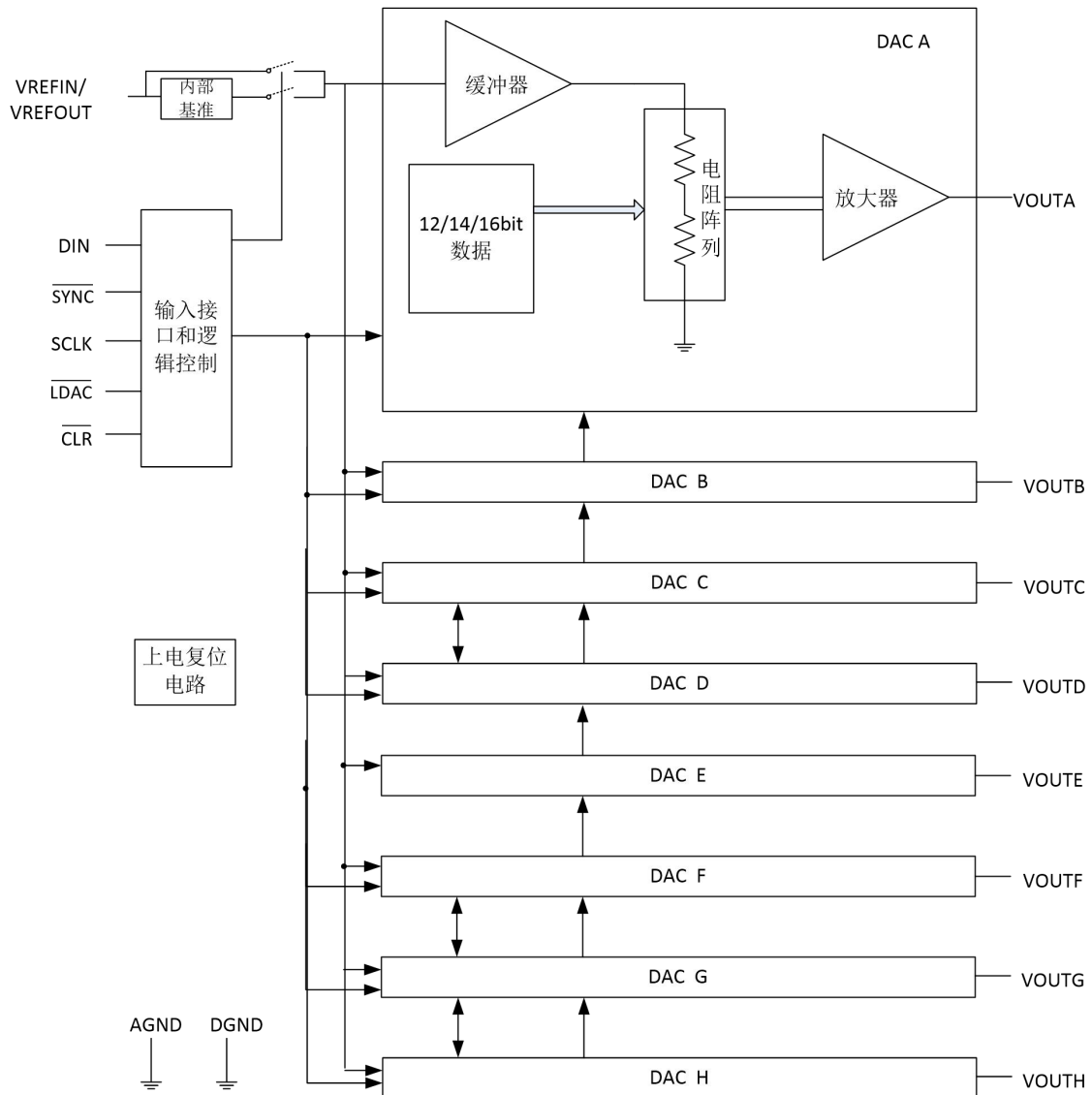
管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
MS5228T1/MS5248T1			
1	$\overline{\text{SYNC}}$	I	SPI 接口的帧同步管脚，下降沿使能内部 SCLK 和 DIN 输入缓冲器和移位寄存器，后 32 个时钟输入数据；如果在 32 个时钟前拉高， $\overline{\text{SYNC}}$ 的上升沿将用作中断
2	VDD	--	电源
3	VOUTA	O	通道 A 模拟输出
4	VOUTC	O	通道 C 模拟输出
5	VOUTE	O	通道 E 模拟输出
6	VOUTG	O	通道 G 模拟输出
7	VREFIN/VREFOUT	I/O	外部基准输入端口/内部基准输出端口
8	VOUTH	O	通道 H 模拟输出
9	VOUTF	O	通道 F 模拟输出
10	VOUTD	O	通道 D 模拟输出
11	VOUTB	O	通道 B 模拟输出
12	GND	--	地
13	DIN	I	SPI 接口的数据输入管脚
14	SCLK	I	SPI 接口时钟输入管脚
MS5228T2/MS5248T2/MS5268T2			
1	$\overline{\text{LDAC}}$	I	DAC 输出实时更新控制端口，低电平有效
2	$\overline{\text{SYNC}}$	I	SPI 接口的帧同步管脚，下降沿使能内部 SCLK 和 DIN 输入缓冲器和移位寄存器，后 32 个时钟输入数据；如果在 32 个时钟前拉高， $\overline{\text{SYNC}}$ 的上升沿将用作中断
3	VDD	--	电源
4	VOUTA	O	通道 A 模拟输出
5	VOUTC	O	通道 C 模拟输出
6	VOUTE	O	通道 E 模拟输出
7	VOUTG	O	通道 G 模拟输出
8	VREFIN/VREFOUT	I/O	外部基准输入端口/内部基准输出端口

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
9	$\overline{\text{CLR}}$	I	异步清零输入，低电平有效
10	VOUTH	O	通道 H 模拟输出
11	VOUTF	O	通道 F 模拟输出
12	VOUTD	O	通道 D 模拟输出
13	VOUTB	O	通道 B 模拟输出
14	GND	--	地
15	DIN	I	SPI 接口的数据输入管脚
16	SCLK	I	SPI 接口时钟输入管脚
MS5228N/MS5268N			
1	VDD	--	电源
2	VOUTA	O	通道 A 模拟输出
3	VOUTC	O	通道 C 模拟输出
4	VOUTE	O	通道 E 模拟输出
5	VOUTG	O	通道 G 模拟输出
6	VREFIN/VREFOUT	I/O	外部基准输入端口/内部基准输出端口
7	$\overline{\text{CLR}}$	I	异步清零输入，低电平有效
8	VOUTH	O	通道 H 模拟输出
9	VOUTF	O	通道 F 模拟输出
10	VOUTD	O	通道 D 模拟输出
11	VOUTB	O	通道 B 模拟输出
12	GND	--	地
13	DIN	I	SPI 接口的数据输入管脚
14	SCLK	I	SPI 接口时钟输入管脚
15	$\overline{\text{LDAC}}$	I	DAC 输出实时更新控制端口，低电平有效
16	$\overline{\text{SYNC}}$	I	SPI 接口的帧同步管脚，下降沿使能内部 SCLK 和 DIN 输入缓冲器和移位寄存器，后 32 个时钟输入数据；如果在 32 个时钟前拉高， $\overline{\text{SYNC}}$ 的上升沿将用作中断

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
MS5228C/MS5268C			
B3	VDD	--	电源
B4	VOUTA	O	通道 A 模拟输出
C4	VOUTC	O	通道 C 模拟输出
C3	VOUTE	O	通道 E 模拟输出
D4	VOUTG	O	通道 G 模拟输出
D3	VREFIN/VREFOUT	I/O	外部基准输入端口/内部基准输出端口
D2	$\overline{\text{CLR}}$	I	异步清零输入，低电平有效
D1	VOUTH	O	通道 H 模拟输出
C1	VOUTF	O	通道 F 模拟输出
C2	VOUTD	O	通道 D 模拟输出
B1	VOUTB	O	通道 B 模拟输出
A1	GND	--	地
A3	DIN	I	SPI 接口的数据输入管脚
A2	SCLK	I	SPI 接口时钟输入管脚
B2	$\overline{\text{LDAC}}$	I	DAC 输出实时更新控制端口，低电平有效
A4	$\overline{\text{SYNC}}$	I	SPI 接口的帧同步管脚，下降沿使能内部 SCLK 和 DIN 输入缓冲器和移位寄存器，后 32 个时钟输入数据；如果在 32 个时钟前拉高， $\overline{\text{SYNC}}$ 的上升沿将用作中断。

内部框图



极限参数

芯片使用中，任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏，芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出，并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。

参数	符号	参数范围	单位
电源电压	VDD	-0.3 ~ +7	V
输入数字电压范围	VIN	-0.3 ~ VDD+0.3	V
基准输入电压范围	VREFIN	-0.3 ~ VDD+0.3	V
工作温度范围	TA	-40 ~ +125	°C
存储温度范围	Tstg	-65 ~ +150	°C
最大结温	Jt	150	°C
焊接温度(10s)		260	°C
ESD (HBM)		4000	V

推荐工作条件

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	5V 供电	4.5	5	5.5	V
	3V 供电	2.7	3	3.3	
数字输入高电平 VIH	VDD = 3V	2			V
	VDD = 5V	2			
数字输入低电平 VIL	VDD = 3V			0.8	V
	VDD = 5V			0.8	
SCLK 速率				40	MHz

注：1. 大于 VDD/2 的输入电压会导致在大的 DAC 输入码时输出饱和。

电气参数

静态 DAC 参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
分辨率	MS5228		12		Bits
	MS5248		14		
	MS5268		16		
微分非线性(DNL)	MS5228, 见注 1		±0.5	±1	LSB
	MS5248, 见注 1		±0.5	±1	
	MS5268, 见注 1		±0.5	±1	
积分非线性(INL)	MS5228, 见注 2		±0.5	±4	LSB
	MS5248, 见注 2		±2	±8	
	MS5268, 见注 2		±8	±32	
零点失调	见注 3		7	20	mV
零点失调温漂	见注 4		10		ppm/°C
增益误差	见注 5			±1	%of FS Voltage
增益误差温漂	见注 6		12		ppm/°C
PSRR	零点	见注 7 和注 8		-80	dB
	满幅			-80	dB

注：1. 微分非线性(DNL)即微分误差，指毗邻 LSB 的最大幅度变化。

2. 积分非线性(INL)即线性误差，测试条件是 $1/128 \times \text{FSR}$ 到 $127/128 \times \text{FSR}$ 的数字码输入。

3. 零点失调指数字输入为零时的模拟输出。

4. 零点失调温漂指数字输入为零时，模拟输出随温度的变化。

5. 增益误差指除去零点失调之后，模拟输出和理想输出的偏差。

6. 增益误差温漂指除去零点失调之后，模拟输出和理想输出的偏差随温度的变化。

7. 零点电源抑制比指当数字输入全零时，VDD 变化 $5 \pm 0.5 \text{ V}$ 和 $3 \pm 0.3 \text{ V}$ 导致输出的变化比。

8. 满幅输出电源抑制比指数字输入全高时，VDD 变化 $5 \pm 0.5 \text{ V}$ 和 $3 \pm 0.3 \text{ V}$ 导致输出的变化比。

DAC 输出参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	RL=10kΩ	0		VDD	V
直流输出阻抗			8		Ω
短路电流	VDD=5V		32		mA
上电时间	退出关断模式，VDD=5V		4		μs

内部基准电压输出参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	1.25V@25°C	1.247	1.25	1.253	V
	2.5V@25°C	2.495	2.5	2.505	
输出阻抗			8		kΩ
温度漂移			10		ppm/°C
开启建立时间	C(REF) =10μF		5		ms

参考输入电压参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	见注 9	0		VDD	V
输入电阻			14.4		kΩ

注 9: 基准输入电压超过 VDD/2 会带来输出饱和失真。

数字输出参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
数字输入高电平电流	VI=VDD			±3	μA
数字输入低电平电流	VI=0V			±3	μA
输入电容			3		pF

功耗参数

参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
电源电流	5V 供电, 输出无负载, 所有输入接 0V 或 VDD, 全部通道开启	开启内部基准		2.6	3.1	mA
		关断内部基准		2.2	2.7	
	3V 供电, 输出无负载, 所有输入接 0V 或 VDD, 全部通道开启	开启内部基准		1.8	2.3	mA
		关断内部基准		1.1	1.6	
掉电电流	VDD=5V			0.47	1	μA
	VDD=3V			0.16	1	

模拟输出动态参数

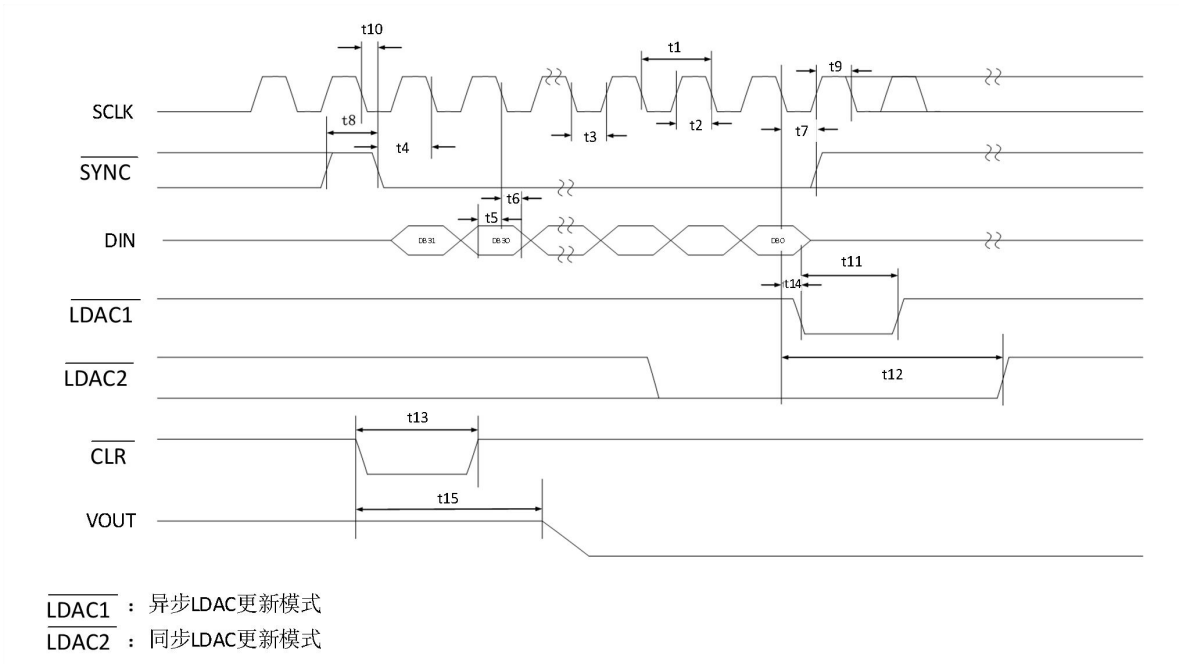
参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
SR	CL=100pF, RL=10kΩ, Vo=10%到 90%, Vref=2.048, 1.024		1.4		V/μs
Ts	到±0.5LSB, CL=100pF, RL=10kΩ		2.2	7	V/μs

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
毛刺能量	从 7FFF 到 8000, VDD=5V		8		nV-sec
	从 EA00 到 E9FF, VDD=5V		37		
模拟串扰	VDD=5V		0.5		nV-sec
通道串扰	VDD=5V		0.8		nV-sec
乘法带宽	VREF=2V±0.2Vp-p		340		kHz
输出噪声谱密度	数字码=0x8400 (16bit 精度), 1kHz		110		nV/√Hz
	数字码=0x8400 (16bit 精度), 10kHz		90		

控制端口-SPI

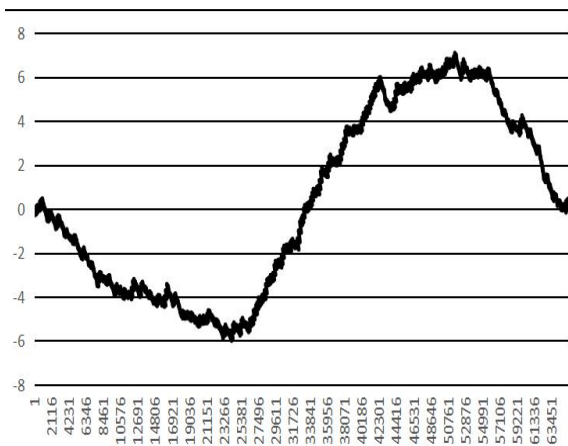
参数		最小值	典型值	最大值	单位
t1	SCLK 周期时间	25			ns
t2	SCLK 高电平时间	10			ns
t3	SCLK 低电平时间	10			ns
t4	$\overline{\text{SYNC}}$ 到 SCLK 下降沿建立时间	14			ns
t5	数据建立时间	5			ns
t6	数据保持时间	5			ns
t7	SCLK 下降沿到 $\overline{\text{SYNC}}$ 上升沿	0			ns
t8	最小 $\overline{\text{SYNC}}$ 高电平时间	15			ns
t9	$\overline{\text{SYNC}}$ 上升沿到 SCLK 忽略的下降沿	14			ns
t10	SCLK 下降沿到 $\overline{\text{SYNC}}$ 忽略的下降沿	0			ns
t11	$\overline{\text{LDAC}}$ 低电平脉冲宽度	12			ns
t12	SCLK 下降沿到 $\overline{\text{LDAC}}$ 上升沿	17			ns
t13	$\overline{\text{CLR}}$ 低电平脉冲宽度	6			ns
t14	SCLK 下降沿到 $\overline{\text{LDAC}}$ 下降沿	0			ns
t15	$\overline{\text{CLR}}$ 脉冲启动时间		300		ns

串口写操作时序图

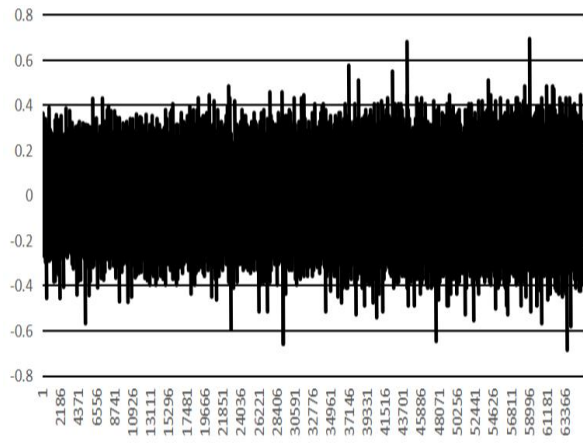


典型曲线图

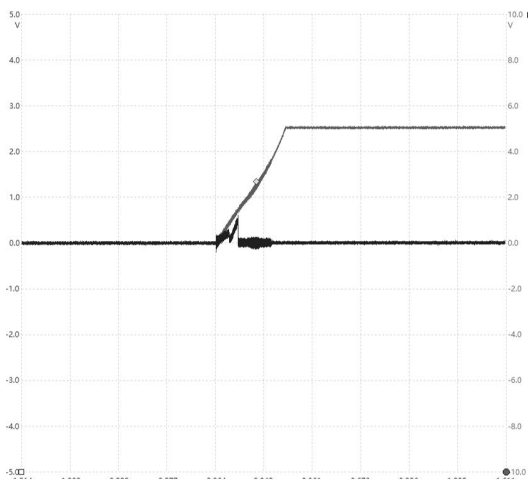
VDD=5V, TA=25°C



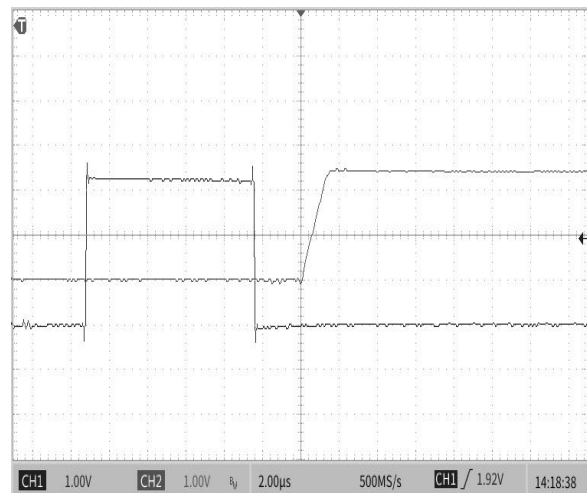
MS5268 INL (@外部基准 5V)



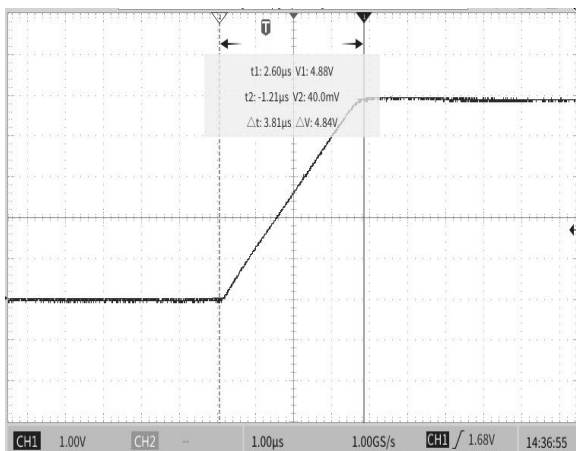
MS5268 DNL (@外部基准 5V)



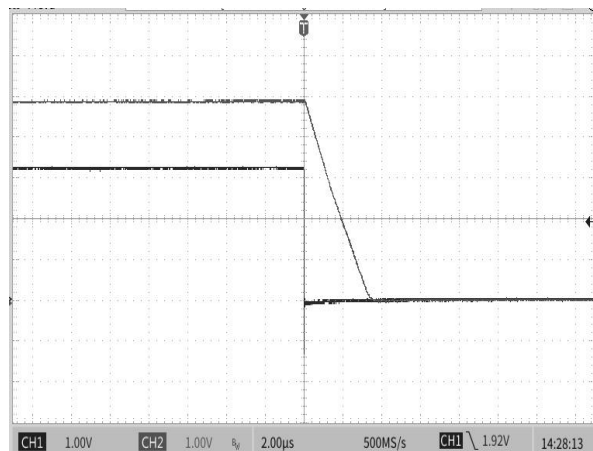
上电复位至 0V



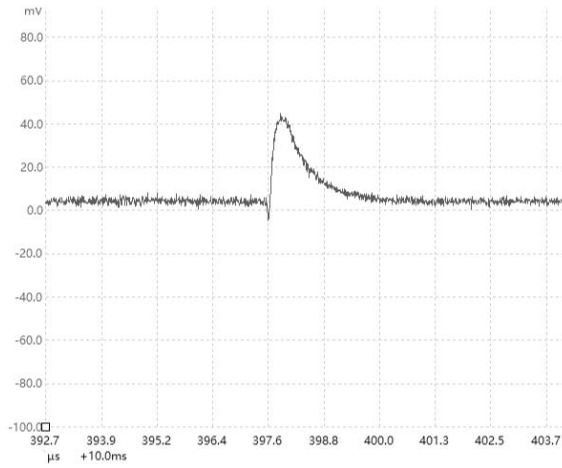
退出掉电模式进入中间电平



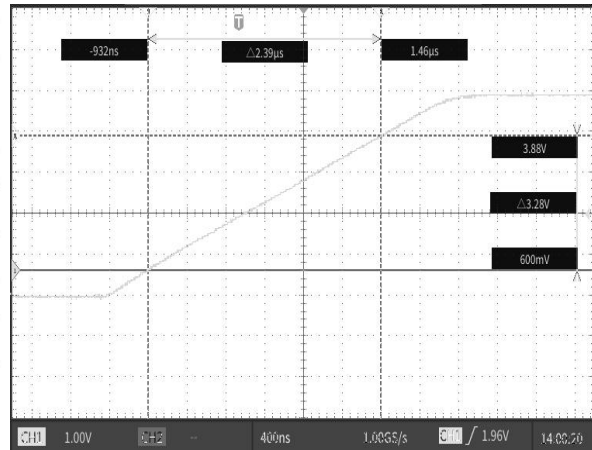
满量程建立时间



硬件 CLR



数模转换毛刺脉冲



MS5268 SR 图 (@CL=10pF)

功能描述

总体功能

MS5228/5248/5268 是一个 12/14/16bit 单电源、带可选内部基准的数模转换器，其架构采用电阻阵列结构，集成了串行接口、速率和关断逻辑控制、基准输入缓冲器、电阻串和输出轨到轨放大器。

内置基准时，输出电压可以表示为：

$$V_{OUT} = 2 \times \frac{V_{REF} \times D}{2^n}$$

其中 MS5228 时，n=12；MS5248 时，n=14；MS5268 时，n=16。

外置基准时，输出电压可以表示为：

$$V_{OUT} = \frac{V_{REF} \times D}{2^n}$$

其中 MS5228 时，n=12；MS5248 时，n=14；MS5268 时，n=16。

基准电压

MS5228/5248/5268 可通过内部寄存器设置选择内部基准或外部基准，内部基准根据芯片版本有 1.25V 和 2.5V。当使用内部基准时，推荐在 VREF 端和 GND 之间使用 100nF 去耦电容。

串行接口

MS5268（16 位），MS5248（14 位），MS5228（12 位）有相同的 3 线串行接口（ \overline{SYNC} ，DIN，SCLK），支持包括 SPI，QSPI，MICROWIRE 在内的多种协议，同时也支持部分 DSP 串口协议。

当 \overline{SYNC} 变为低电平后，启动写操作，数据由 DIN 端在 32 个 SCLK 下降沿写入移位寄存器，最后一位数据写入后判断功能，并进行后续操作。在写操作期间， \overline{SYNC} 必须保持低电平，写入完成后可继续保持低电平，也可以拉高，但在下一次写数据前，必须先保持 15ns 以上的高电平，才能正常工作。

空闲期间建议把 \overline{SYNC} 拉低以减少功耗。

C3-C0 是命令位，A3-A0 是地址位。

表 1. 命令定义

命令位				功能描述
C3	C2	C1	C0	
0	0	0	0	写入地址选定的输入寄存器
0	0	0	1	更新地址选定的 DAC 寄存器（优先级高于 \overline{LDAC} 端口配置）
0	0	1	0	写入地址选定的输入寄存器，并更新所有 DAC 寄存器（ $\overline{LDAC}=0$ 可做到即时更新所有寄存器）（优先级高于 \overline{LDAC} 端口配置）
0	0	1	1	写入地址选定的输入寄存器，且只更新地址选定的 DAC 寄存器（优先级高于 \overline{LDAC} 端口配置）
0	1	0	0	DAC 的上电/掉电
0	1	0	1	加载清零编码器

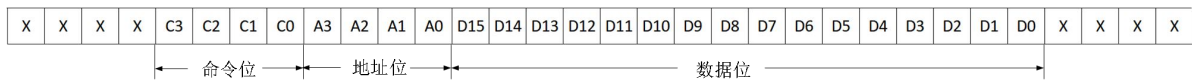
命令位				功能描述
0	1	1	0	加载 $\overline{\text{LDAC}}$ 寄存器数据
0	1	1	1	复位（上电复位）
1	0	0	0	设置内部基准电压
1	0	0	1	保留
....				保留
1	1	1	1	保留

表 2. 地址命令

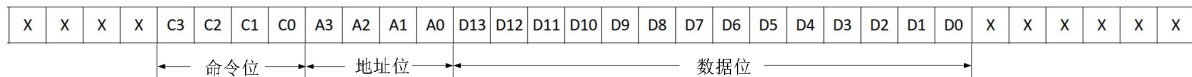
地址位				选择的 DAC 通道
A3	A2	A1	A0	
0	0	0	0	DAC A
0	0	0	1	DAC B
0	0	1	0	DAC C
0	0	1	1	DAC D
0	1	0	0	DAC E
0	1	0	1	DAC F
0	1	1	0	DAC G
0	1	1	1	DAC H
1	1	1	1	所有 DAC

输入移位寄存器

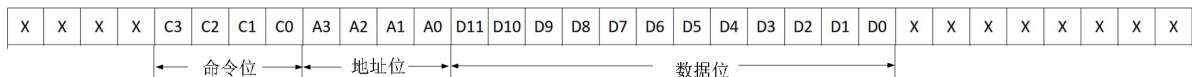
输入移位寄存器的功能如图 1 所示：



MS5268



MS5248



MS5228

图 1. 输入寄存器

SYNC 中断

写操作中，在输入 32 位数据期间， $\overline{\text{SYNC}}$ 须保持低电平，在第 32 个 SCLK 的下降沿会进行功能判断并把数据传递给 DAC 寄存器，如果提早拉高 $\overline{\text{SYNC}}$ ，输入会被强制终止，此段数据会被认为无效（参见图 2）。

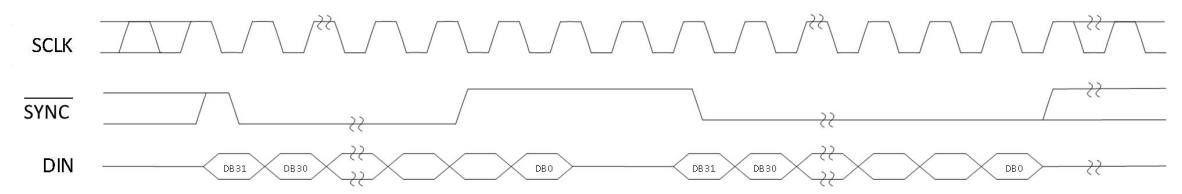


图 2. SYNC 中断方式图

内部基准电压寄存器

在默认情况下，芯片关闭内部基准电压。内部 REF 寄存器的 DB0 位设为高电平或低电平，可以开启或关闭内部基准电压源，命令 1000 用于内部 REF 寄存器的设置（参见表 3，表 4）。

表 3. 内部基准寄存器

DB0	操作
0	关闭内部基准电压（默认状态）
1	开启内部基准电压

MSB

表 4. 基准设置指令

DB31~DB28	DB27	DB26	DB25	DB24	DB23	DB22	DB21	DB20	DB19~DB1	DB0
X	0	1	0	0	X	X	X	X	X	1/0
无关位									无关位	内部基准电压控制

上电复位

上电复位功能是在上电时控制输出电压的值。MS5228/MS5248/MS5268 的 DAC 在上电后输出 0 V。上电的电平输出会一直持续，直到运行有效的写命令。命令 0111 可控制 DAC 输出上电默认值（参见表 1）。

上电复位期间，忽略 $\overline{\text{LDAC}}$ 和 $\overline{\text{CLR}}$ 的变化。

掉电模式

用命令 0100 可通过输入的其中两位 (DB9 和 DB8) 选择四种工作模式, 对应关系参见表 5, 图 3 显示了输出电路示意图。

DB9 和 DB8 可控制相应的 DAC 通道开启/关闭 (参见表 6)。如果使用内部基准电压, 仅支持所有通道关断到选定的模式。

表 5. 关断工作模式

DB9	DB8	工作模式
0	0	正常工作
0	1	掉电模式, DAC 输出对地接 1kΩ电阻
1	0	掉电模式, DAC 输出对地接 100kΩ电阻
1	1	掉电模式, DAC 输出高阻

MSB

表 6. 关断/上电功能的 32 位输入移位寄存器内容

DB31~DB28	DB27	DB26	DB25	DB24	DB23	DB22	DB21	DB20	DB19~DB10
X	0	1	0	0	X	X	X	X	X
无关位	C3-C0 命令位				A3-A0 地址位				无关位

DB9	DB8	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
PD1	PD0	DAC H	DAC G	DAC F	DAC E	DAC D	DAC C	DAC B	DAC A
掉电模式		上电/关断通道选择, 如果相应位设为 1, 可关断相应通道							

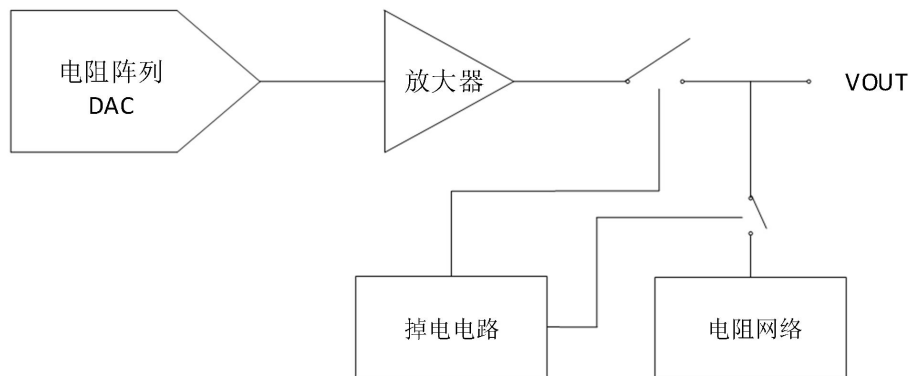


图 3. 输出电路

清零编码寄存器

MS5228/MS5248/MS5268 有一个硬件异步清零输入引脚 $\overline{\text{CLR}}$ ， $\overline{\text{CLR}}$ 下降沿有效。命令 0101 选择配置清零后 DAC 状态，共有四种状态可选（参见表 7）。

改变 0101 命令输入时的 DB1, DB0，就能对清零后的值进行配置（参见表 8）。进入清零编码配置模式，器件将在下一次写操作的第 32 个下降沿退出。如果 $\overline{\text{CLR}}$ 在写操作期间有效，写操作将被中止。

表 7. 清零编码寄存器

清零编码寄存器		清零编码
DB1(CR1)	DB0(CR0)	
0	0	0x0000
0	1	0x8000
1	0	0xFFFF
1	1	无操作

MSB 表 8. 清零编码功能的 32 位输入移位寄存器内容

DB31~DB28	DB27	DB26	DB25	DB24	DB23	DB22	DB21	DB20	DB19~DB2	DB1	DB0
X	0	1	0	1	X	X	X	X	X	CR1	CR0
无关位	C3-C0 命令位				A3-A0 地址位				无关位	清零编码寄存器	

$\overline{\text{LDAC}}$ 功能

使用 $\overline{\text{LDAC}}$ 可以更新所有 DAC 的输出，更新分为硬件和软件两种模式，在硬件更新模式下也分为同步和异步 $\overline{\text{LDAC}}$ 。

硬件同步 $\overline{\text{LDAC}}$ ：写入新数据的第 32 个 SCLK 的下降沿，如果此时 $\overline{\text{LDAC}}$ 为低电平，则自动更新所有 DAC 通道。 $\overline{\text{LDAC}}$ 可以永久接为低电平。

硬件异步 $\overline{\text{LDAC}}$ ：DAC 输出不在新数据写入时更新，直到 $\overline{\text{LDAC}}$ 变为低电平时，DAC 寄存器更新为写入的相应值。

软件更新可以只更新选定的多个 DAC 寄存器，也可以同时更新所有 DAC。寄存器位 $\overline{\text{LDAC}}$ 配置为高电平，则所有通道都更新；寄存器位 $\overline{\text{LDAC}}$ 配置为低电平，则只更新选定的 DAC 通道（参见表 9，表 10）。

表 9. $\overline{\text{LDAC}}$ 寄存器

加载 DAC 寄存器		$\overline{\text{LDAC}}$ 操作
$\overline{\text{LDAC}}$ 位 (DB7~DB0)	$\overline{\text{LDAC}}$ 引脚	
0	1/0	由 $\overline{\text{LDAC}}$ 引脚决定
1	X (无关位)	所有 DAC 通道更新，无视命令的 $\overline{\text{LDAC}}$ 设置位

MSB 表 10. $\overline{\text{LDAC}}$ 寄存器功能的 32 位输入移位寄存器内容

DB31~DB28	DB27	DB26	DB25	DB24	DB23	DB22	DB21	DB20	DB19~DB8
X	0	1	1	0	X	X	X	X	X
无关位	C3-C0 命令位				A3-A0 地址位				无关位

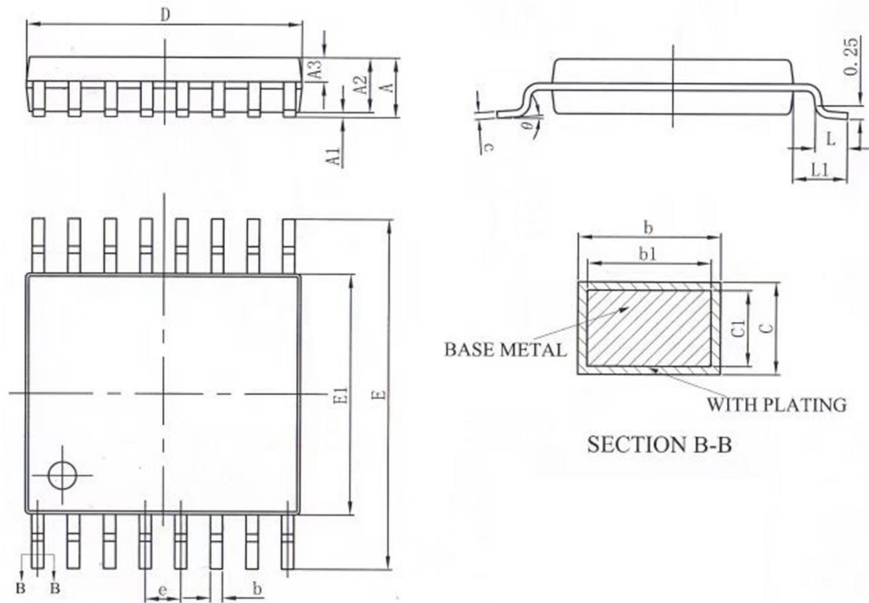
DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
DAC H	DAC G	DAC F	DAC E	DAC D	DAC C	DAC B	DAC A
$\overline{\text{LDAC}}$ 位设为 1 将覆盖 $\overline{\text{LDAC}}$ 引脚							

电源供电旁路和地管理

PCB 应将模拟地和数字地分开，建议模拟地连接在系统的模拟地，以提高系统性能。一个 $0.1\mu\text{F}$ 的陶瓷电容旁路应该接在 VDD 和 GND 之间，并且放置在离芯片尽可能近的地方，若使用磁珠，可进一步减少数字电源对模拟电源的干扰。

封装外形图

TSSOP16



符号	尺寸 (毫米)		
	最小	典型	最大
A	-	-	1.20
A1	0.05	-	0.15
A2	0.90	1.00	1.05
A3	0.39	0.44	0.49
b	0.20	-	0.28
b1	0.19	0.22	0.25
c	0.13	-	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	4.90	5.00	5.10
E	6.20	6.40	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
e	0.65BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00BSC		
θ	0	-	8°

印章与包装规范

1. 印章内容介绍



产品型号：MS52X8T1（X 代表 2，4）；MS52X8T2（X 代表 2，4，6）；

MS52X8N（X 代表 2，6）；MS52X8C（X 代表 2，6）

生产批号：XXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS5228T1	TSSOP14	3000	1	3000	8	24000
MS5228T2	TSSOP16	3000	1	3000	8	24000
MS5228N	QFN16	4000	1	4000	8	32000
MS5228C	CSP16	5000	1	5000	8	40000
MS5248T1	TSSOP14	3000	1	3000	8	24000
MS5248T2	TSSOP16	3000	1	3000	8	24000
MS5268T2	TSSOP16	3000	1	3000	8	24000
MS5268N	QFN16	4000	1	4000	8	32000
MS5268C	CSP16	5000	1	5000	8	40000

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时，买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失！
- 产品提升永无止境，本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！



MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电的影响而引起的损坏：

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-181 2023 5245



武汉市江夏区光谷大道联
享企业中心G栋二单元901
室



<https://www.vertex-icbuy.com/>